

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☒其他券商策略会、电话会议
参与单位名称及人员姓名	广发证券（7月8日） 太平养老保险（7月8日） 国投证券（7月8日） 国投创业投资管理（7月8日） 博时基金（7月8日） 昭图投资管理（7月8日） 华福证券（7月8日） 诺安基金（7月8日） 鹏华基金（7月8日） 信达澳亚基金（7月8日） 深圳恒德投资（7月8日） 民生证券（7月9日） 兴业证券（7月9日） 华创证券策略会（7月10日） 长江证券策略会（7月16日） 华泰证券（7月17日） 中欧基金（7月17日） 永赢基金（7月17日）

	华创证券（7月18日）
时间	2025 年 7 月 8 日-7 月 18 日
地点	公司会议室、上海、北京
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营情况 2024 年以来，AI 服务器及数通产品需求持续上升，加上智能手机、汽车电子等电子终端产品的技术升级，共同推动 PCB 行业各类细分产品的成长，特别是高多层板及 HDI 板市场增长迅猛，持续带动 PCB 产业市场规模上升及下游客户资本支出增加。公司深耕行业，营收及利润进一步上升，2025 年第一季度实现营业收入 95,984.87 万元，同比增长 27.89%，归属于上市公司股东的净利润 11,677.35 万元，同比增长 83.60%。 二、公司产品情况 公司构建了覆盖多层板、HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等不同细分 PCB 市场及层压、钻孔、曝光、成型、检测等关键工序的立体化产品矩阵，为 PCB 不同细分领域的客户提供差异化的一站式工序解决方案。2024 年，公司不断完善各类型产品线布局并提升竞争能力，进一步丰富产品矩阵内涵，压合系统、十二轴自动化机械钻孔机、自动上下料机机械成型机、四光束 CO₂ 激光钻孔机、新型激光加工设备、玻璃基板 TGV 成套设备等行业创新型产品获得客户认可，全部达到批量市场推广水平，部分产品已经实现大批量订单。针对行业发展快速的 AI 服务器高多层板，提供包括高精度通孔、盲孔、背钻加工设备，高解析度及层间对准度激光成像系统、高精密质量检测设备等，满足该类高速 PCB 更高信号完整性加工需求，赋能行业技术升级。 三、PCB 行业发展趋势 根据行业知名研究机构 Prismark 最新分析报告，受益于 AI 产业链基础设施需求爆发的推动，叠加消费电子复苏、汽车电子技术升级等多重利好因素，2024 年全球电子终端产业营收呈现增长趋势；而 2025 年全球 PCB 产业在 AI 产业链推动下将持续成长，增

	幅预期调高至 7.6%，并对行业的中长期发展趋势维持积极展望，预估 2024-2029 年 PCB 行业营收复合增长率为 5.2%，产量的复合增长率更是高达 6.8%，其中 18 层以上高多层板、IC 封装基板及 HDI 板保持较高增速，未来五年复合增长率分别为 15.7%、7.4%、6.4%，对应的终端产品为 AI 算力服务器、高速通讯设施、AIPC 及 AI 智能手机等，PCB 产业的增长依然以 AI 产业带动为主。 另一方面，受 PCB 产业链 China+N 的加速推进影响，泰国、越南、马来西亚等东南亚国家未来几年扩产项目的产能将持续增加，其 2024-2029 年复合成长率高达 7.1%，高于中国大陆 4.3% 的增长水平，但由于东南亚地区 PCB 产业基数较小，PCB 产业增加值远低于中国大陆，长期来看，中国大陆的市场地位较为稳固。 四、高多层及高多层 HDI 板市场情况 在高多层板市场，随着数据量大幅攀升，AI 服务器、高速交换机等产品纷纷采用更高层数的多层板，下一代 112/224Gbps 高速数据传输对信号完整性的保障提出更高要求，高多层板背钻的精度要求大幅提升，公司开发的新型 CCD 六轴独立机械钻孔机搭载 3D 背钻及钻测一体技术，可实现超短残桩和超高同心度，已获得行业多家高多层板龙头企业的认可及批量订单；同时，针对高多层板高厚径比通孔钻孔、高精度层间对位及高可靠性电性能测试等技术要求，公司提供更多产品组合方案，包含大扭力主轴钻孔设备、超高层间对位精度数字成像系统、大台面六倍密通用测试机及大点数 CCD 四线测试机产品，助力下游客户提升该类高附加值产品的生产良率及品质信赖度。 市场增长最为显著的 AI 服务器用高多层 HDI 板，其产品更加结构复杂，其中导通孔的形式包含埋通孔、通孔、背钻孔、盲孔、跨层盲孔，且都集中在单片 PCB 上，融合了高多层板及高密度板的双重特性。公司是行业内少数可提供对应成套解决方案的企业，并针对该类产品厚度大、重量大的特点优化产品传输及夹持系统，提供机械钻孔机、3D 背钻及钻测一体 CCD 背钻机、CO₂ 激光钻孔机、UV 激光钻孔机等；同时，该类 PCB 线路一致性要求极高，公司提供高分辨率及高层间对位精度的数字成像系统，获得国内外客户信赖；另外，该类产品结构复杂，增加了质量的不确定性，公司提供超大点数四线测试机，获得全球顶级 AI 服务器 PCB 生产厂商的高度评价。
--	--

	五、海外市场情况 以泰国为热点的东南亚地区 PCB 新建项目快速推进，公司海外市场业务取得较大程度增长。随着全球主要电子终端品牌实施多元化的供应链策略，并将与信息安全相关的 AI 服务器、卫星通讯、光模块、汽车智能驾驶等 PCB 作为布局重点，带动了更多高多层板、高阶 HDI 板产能的建设，除常规的机械钻孔机、高效数字成像系统、通用测试机等设备外，高技术附加值的 CCD 六轴独立机械钻孔机、CO₂ 激光钻孔机、高解析数字成像系统、高精微针测试机等需求量上涨，有利于公司相关产品海外市场销售规模及利润空间的提升。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 18 日